

適用於晶片、MELF、引線電容之測包機



- 對應CE安全規範
- 搭載接觸檢知(CONTACT CHECK)功能
- 測定時間:1.2msec
- 微小電容到大電容廣泛範圍的測定檔位(20pF~200 μ F Range)
- 測定頻率:1kHz \pm 0.1%(正弦波)
- 五端點測定方式
- 搭載微處理器輸出 HI/GO/LO
- 3位半(1999)數位顯示
- 選配GP-IB或RS-232C(OPTION)
- 搭載印表機輸出(搭載Centronics)
- 即使測定中也可輸出測定值、 δ 、3 δ 、mas.、min.、日期、時間等數值至印表機

Specifications

測定範圍及準確度(周圍溫度23°C \pm 5°C)※D<0.1 並聯等價回路

測定檔位	測定準確度	測定電壓
20pF	$\pm 0.25\%$ of rdg ± 2 digit ± 0.01 pF以內	1V
200pF		
2nF		
20nF		
200nF		
2 μ F		
20 μ F	$\pm 0.2\%$ of rdg ± 2 digit以內	1V以下
200 μ F		
	$\pm 0.8\%$ of rdg ± 3 digit以內[※100 μ F以內]	

※100 μ F以下為($\pm 0.8\%$ of rdg ± 3 digit) \times 測定值[μ F]/100以內

測定方式	五端點測定方式、並聯等價回路
測定頻率	1kHz $\pm 0.1\%$ 、正弦波
寄生電容補償範圍	約20pF
全核度及零點溫度係數	± 100 ppm/ $^{\circ}$ C以內
測定時間	[外部啟動] 1.2msec.
	[Free Running] 5~10次/秒
比較器設定範圍	HI/LO皆為1999
使用周圍環境	溫度:5 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C、濕度:85%以下
電源需求	AC100V~240V切換、50/60Hz、約30VA
外觀尺寸	約333(W) \times 99(H) \times 300(D)mm (不包含橡膠墊等凸出物。)
重量	約5.8kg

Option

- GP-IB
 - RS-232C
- ※可選擇一種上述選配功能